

香港交易結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION**

**中芯國際集成電路製造有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：981)

## **須予披露及關連交易 於北京成立合資企業**

### **成立合資企業**

謹此提述本公司日期為2020年7月31日的公告，內容有關就本公司與北京開發區管委會訂立合作框架協議披露內幕消息。根據合作框架協議，本公司和北京開發區管委會有意在中國共同成立一家合資企業，負責發展和營運該項目。

本公司欣然宣佈，於2020年12月4日(交易時段後)，中芯控股、國家集成電路基金II和亦莊國投訂立合資合同以共同成立合資企業。合資企業的註冊資本為50億美元，中芯控股、國家集成電路基金II和亦莊國投各自同意出資25.5億美元、12.245億美元和12.255億美元，分別佔合資企業註冊資本51%、24.49%和24.51%。

### **香港上市規則的涵義**

由於國家集成電路基金II持有中芯南方23.077%股權，而鑒於中芯控股有權委任中芯南方董事會多數董事及該等董事可全權酌情否決中芯南方董事會會議上審議的若干重大事項，故中芯南方被視為本公司附屬公司，因此國家集成電路基金II通過作為中芯南方主要股東(定義見香港上市規則)而於附屬公司層面為本公司關連人士。因此，合資合同構成本公司於香港上市規則第14A章項下的關連交易。

由於有關合資合同於香港上市規則第14.07條規定的若干適用百分比率高於5%但低於25%，故合資合同構成香港上市規則第14章項下的須予披露交易。

由於(i)董事會已批准合資合同及據此擬進行的交易；及(ii)董事會(包括獨立非執行董事)已確認合資合同及據此擬進行的交易的條款屬公平合理，乃按一般商業條款訂立，且符合本公司和其股東的整體利益，故根據香港上市規則第14A.101條，合資合同僅須符合申報和公告規定，但獲豁免遵守通函、獨立財務意見和獨立股東批准規定。

## 成立合資企業

謹此提述本公司日期為2020年7月31日的公告，內容有關就本公司與北京開發區管委會訂立合作框架協議披露內幕消息。根據合作框架協議，本公司和北京開發區管委會有意在中國共同成立一家合資企業，負責發展和營運該項目。

本公司欣然宣佈，於2020年12月4日(交易時段後)，中芯控股、國家集成電路基金II和亦莊國投訂立合資合同以共同成立合資企業。合資企業的註冊資本為50億美元，中芯控股、國家集成電路基金II和亦莊國投各自同意出資25.5億美元、12.245億美元和12.255億美元，分別佔合資企業註冊資本51%、24.49%和24.51%。

## 合資合同

合資合同的主要條款載列如下：

### 日期

2020年12月4日

### 訂約方

- (a) 中芯控股；
- (b) 國家集成電路基金II；及
- (c) 亦莊國投。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，基於本公告披露的理由及除亦莊國投於中芯北方的5.75%股權外，除國家集成電路基金II外，亦莊國投和其最終實益擁有人均為獨立於本公司和本公司關連人士的第三方。

## 業務範圍

合資企業的業務範圍包括生產12吋集成電路晶圓及集成電路封裝系列；技術測試；集成電路相關技術開發、技術服務及設計服務；銷售自產產品(對須根據相關法律審批的項目，將按照相關機構核定的審批內容開展業務活動)(受限於市場監管機關最終審批及備案的內容)。

## 註冊資本和出資

合資企業的總投資額為76億美元，註冊資本為50億美元。

各位股東的出資詳情載列如下：

股東	出資 (美元)	出資方式	股權
中芯控股	25.5億	現金	51%
國家集成電路基金II	12.245億	現金	24.49%
亦莊國投	12.255億	現金	24.51%

經合資企業董事會批准，合資企業可自國內外銀行或其他金融或非金融機構或自合資合同訂約方集資，以補足總投資額與註冊資本之間的差額。經合資企業董事會批准，合資企業可按揭或質押其資產，以籌集和取得上述資金。

本公司對合資企業的出資額根據本公司的戰略規劃、自身財務與資金情況確定，該投資資金全部來源於本公司的自有資金。各位股東須於2020年12月31日前注入議定出資的30%，並須於2024年12月31日前付清議定出資的餘下70%款額。於上述出資期限之間，合資企業可根據實際資本需求及在董事會會議上形成一致意見及作出決議後，向各方發出出資通知，要求相關訂約方分期或一次過完成出資。最後一期出資須不遲於2024年12月31日。如果任何一方於出資時間表的任何階段未有履行其責任支付議定比例出資，其他訂約方有權拒絕支付其出資部分。

中芯控股將以美元現匯或等值於相應美元的人民幣進行注資，其他訂約方則以等值於相應美元的人民幣進行注資。適用匯率將按出資當天中國人民銀行發佈的人民幣兌美元的中間價計算匯率。

### **合資企業董事會的組成**

合資企業董事會將由五名董事組成，其中三名董事由中芯控股提名、一名董事由國家集成電路基金II提名，及一名董事由亦莊國投提名。董事將由股東於股東大會上選舉得出。董事會董事長將由合資企業董事會選舉得出。

### **合資企業監事會的組成**

合資企業監事會將由三名監事組成，其中一名監事由國家集成電路基金II提名並由股東於股東大會上選舉得出、一名監事由亦莊國投提名並由股東於股東大會上選舉得出，及一名監事由合資企業僱員代表提名及選出。監事會主席將由監事會選舉得出。

## 轉讓限制

只要中芯控股仍為合資企業的單一最大控股股東，合資合同的所有訂約方有權購買其他方於合資企業的全部或部分股權。如任何股東有意將其於合資企業的股權轉讓予第三方，其他非轉讓方有權按不遜於向第三方提供的價格、條款和條件購買所有將予轉讓的股權。任何非控股股東如欲轉讓其認購但未繳足的合資企業股權，須事先取得中芯控股的書面同意。如中芯控股和國家集成電路基金II有意購買亦莊國投於合資企業的全部或部分股權，須遵守有關國有股權轉讓的相關法律法規。

在中芯控股仍為合資企業股東的前提下，國家集成電路基金II和亦莊國投同意，合資合同項下合資企業股權的建議受讓人不得涉足與本公司和其控股關聯方的業務和產品構成競爭的業務和產品，也不得為從事與集成電路製造業務構成競爭的業務的公司。

## 其他條款

根據合資合同，只要中芯控股仍為合資企業的單一最大控制股東，中芯控股將促使本公司和其指定關聯方同意授權合資企業使用包括上述公司可合法使用的28納米及以上技術在內的製造技術。有關授權安排將於合資企業成立後由合資企業與本公司和其指定關聯方另行簽署授權協議而達成。

合資企業的經營期限將自成立之日起計為期50年。合資合同訂約方經一致同意後，可延長合資企業的經營期限。

合資合同項下有關各訂約方的條款須符合適用法律(包括聯交所和上交所等監管機構的規定)。

## 成立合資企業的理由和益處

本公司認為，成立合資企業可以滿足不斷增長的市場和客戶需求，有助本公司擴大生產規模，降低生產成本，精進晶圓代工服務，從而推動本公司的可持續發展。

董事(包括獨立非執行董事)認為，合資合同的條款屬公平合理，且合資合同和其項下擬進行的交易是按正常商業條款於本公司一般和日常業務過程中訂立，符合本公司和其股東的整體利益。

除路軍先生(彼為本公司第二類非執行董事及提名委員會成員，亦擔任國家集成電路基金II董事)外，概無董事被視為於合資合同中擁有重大利益，而使董事須於董事會會議上就授權合資合同放棄投票。

## 香港上市規則的涵義

由於國家集成電路基金II持有中芯南方23.077%股權，而鑒於中芯控股有權委任中芯南方董事會多數董事及該等董事可全權酌情否決中芯南方股東大會上審議的若干重大事項，故中芯南方被視為本公司附屬公司，因此國家集成電路基金II通過作為中芯南方主要股東(定義見香港上市規則)而於附屬公司層面為本公司關連人士。因此，合資合同構成本公司於香港上市規則第14A章項下的關連交易。

由於有關合資合同於香港上市規則第14.07條規定的若干適用百分比率高於5%但低於25%，故合資合同構成香港上市規則第14章項下的須予披露交易。

由於(i)董事會已批准合資合同及據此擬進行的交易；及(ii)董事會(包括獨立非執行董事)已確認合資合同及據此擬進行的交易的條款屬公平合理，乃按一般商業條款訂立，且符合本公司和其股東的整體利益，故根據香港上市規則第14A.101條，合資合同僅須符合申報和公告規定，但獲豁免遵守通函、獨立財務意見和獨立股東批准規定。

根據上交所科創板相關規則，合資合同及其項下擬進行的交易構成關聯交易，亦須在上交所作出披露。



## 有關訂約方的資料

### 本公司及中芯控股

本公司和其附屬公司共同構成世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地技術最先進全面、配套最完善、規模最大、跨國經營的集成電路製造企業，提供0.35微米到14納米不同技術節點的晶圓代工和技術服務。本集團總部位於中國上海，擁有全球化的製造和服務基地。在上海建有一座300mm晶圓廠、一座200mm晶圓廠和一座實際控股的300mm先進制程晶圓合資廠；在北京建有一座300mm晶圓廠和一座控股的300mm晶圓廠；在天津和深圳各建有一座200mm晶圓廠；在江陰有一座控股的300mm凸塊加工合資廠。本集團還在美國、歐洲、日本和中國台灣地區設立行銷辦事處、提供客戶服務，同時在香港設立了代表處。中芯控股作為跨國公司地區總部，成立於2015年，為本公司的全資附屬公司，主要作為投資控股平台。

### 國家集成電路基金II

國家集成電路基金II於2019年10月註冊成立，透過股權投資，主要投資於集成電路產業的價值鏈，其中以集成電路芯片生產、芯片設計、封裝測試以及設備及材料為主。國家集成電路基金II有27名基金投資者，包括(其中包括)中國財政部(為單一最大股東，持有11.02%持股權益)、國開金融(持有10.78%持股權益)、成都天府國集投資有限公司(持有7.35%持股權益)、重慶戰略性新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)(持有7.35%持股權益)、武漢光谷金融控股集團有限公司(持有7.35%持股權益)、中國煙草總公司(持有7.35%持股權益)、上海國盛(集團)有限公司(持有7.35%持股權益)、浙江富浙集成電路產業發展有限公司(持有7.35%持股權益)及一組19名股東(各持有少於7%持股權益，當中包括公司、合夥企業及華芯投資管理有限責任公司(該公司亦擔任基金經理))。有關國家集成電路基金II的進一步詳情，請參閱本公司日期為2020年6月6日的通函。

## 亦莊國投

亦莊國投創立於2009年2月，為北京經濟技術開發區財政審計局全資附屬公司。作為一家就北京經濟技術開發區產業轉型升級而成立的國有投資公司，亦莊國投可提供創新金融服務以滿足當地企業發展需要。通過長週期戰略投資，同時搭建全流程的母基金體系，並依靠市場實力，發展多元化的產業投資及金融服務，旨在促進集成電路發展，以創造智能產業集群。於本公告日期，亦莊國投持有中芯北方5.75%股權。

## 釋義

除非文義另有所指外，本公告內的下列詞彙具有以下涵義：

「北京開發區管委會」	指	北京經濟技術開發區管理委員會
「董事會」	指	董事會
「國家集成電路基金II」	指	國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司，一家根據中國法律成立的公司
「本公司」	指	Semiconductor Manufacturing International Corporation (中芯國際集成電路製造有限公司*)，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板及上交所科創板上市
「合作框架協議」	指	本公司和北京開發區管委會於2020年7月31日訂立的合作框架協議，內容有關(其中包括)建議成立合資企業
「董事」	指	本公司董事
「亦莊國投」	指	北京亦莊國際投資發展有限公司，一家根據中國法律成立的公司
「本集團」	指	本公司和其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	聯交所證券上市規則



「合資合同」	指	中芯控股、國家集成電路基金II和亦莊國投於2020年12月4日訂立的有關合資企業的合資合同
「合資企業」	指	中芯京城集成電路製造(北京)有限公司，一家將根據合資合同於中國成立的有限責任公司，作為本公司的非全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「該項目」	指	在北京開發12吋晶圓生產設施
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	合資企業股東
「中芯控股」	指	中芯國際控股有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司
「中芯北方」	指	中芯北方集成電路製造(北京)有限公司，一家根據中國法律成立的公司，並為本公司的非全資附屬公司
「中芯南方」	指	中芯南方集成電路製造有限公司，一家根據中國法律成立的中外合資企業，並為本公司的非全資附屬公司
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣

承董事會命  
**中芯國際集成電路製造有限公司**  
**高永崗**  
 執行董事、首席財務官兼公司秘書

上海，2020年12月4日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

周子學(董事長)

趙海軍(聯合首席執行官)

梁孟松(聯合首席執行官)

高永崗(首席財務官兼公司秘書)

**非執行董事**

陳山枝

周杰

任凱

路軍

童國華

**獨立非執行董事**

William Tudor Brown

叢京生

劉遵義

范仁達

楊光磊

\* 僅供識別